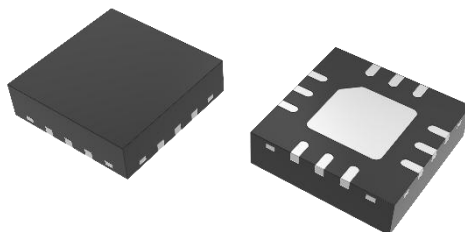


特点:

- 频率范围: 0.01~12.00GHz
- 插入损耗: 典型值1.5dB
- 耦合度: 典型值26dB
- QFN 塑封
- 尺寸: 3.0×3.0×1.2mm

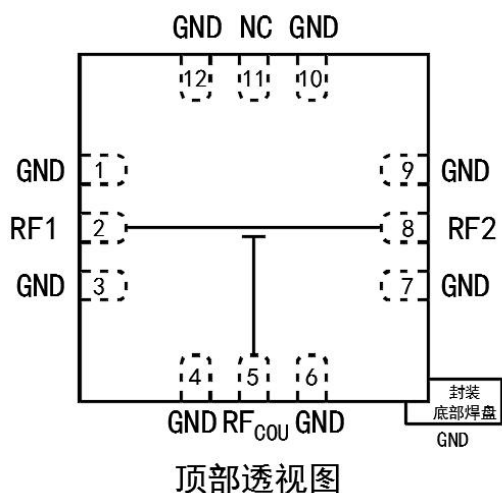
图片:



性能参数: (50Ω系统, T_A=-55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	f=0.01~12.00GHz P _{IN} =0dBm	0.01		12.00	GHz	
插入损耗	IL			1.5	3	dB	
带内平坦度	ΔIL			1.5	2.5	dB	
直通端口驻波	VSWR _{IO}			1.4:1	1.65:1		
耦合端口驻波	VSWR _{COU}			1.4:1	1.65:1		
耦合度	COU		24	26		dB	

功能框图:



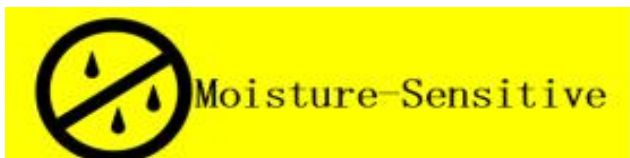
引脚定义:

引脚编号	符号	描述
2	RF1	射频输入/输出端口, DC 耦合
8	RF2	射频输入/输出端口, DC 耦合
5	RF _{COU}	耦合输出端口, DC 耦合
11	NC	悬空, 建议接地
1/3/4/6/7/9/10/12	GND	接地
底部中央焊盘	GND	接地

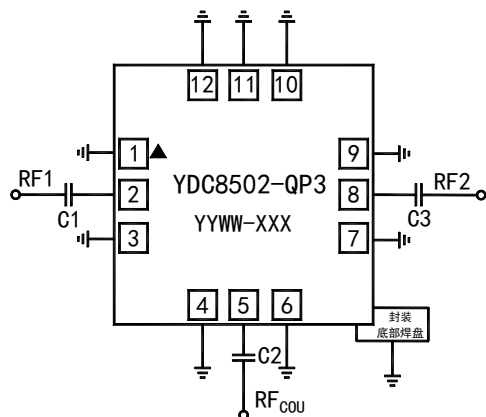
极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+27dBm
装配温度	+260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-65~+150℃
潮湿敏感等级 (MSL)	3
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。



推荐应用电路：

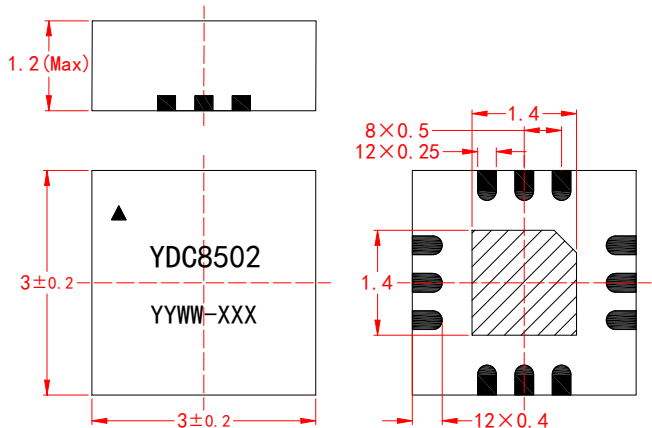


推荐电路值：

位号	型号/数值	备注
C1 C2 C3	1nF	

注：外部无直流电压输入，可以不加隔直电容。

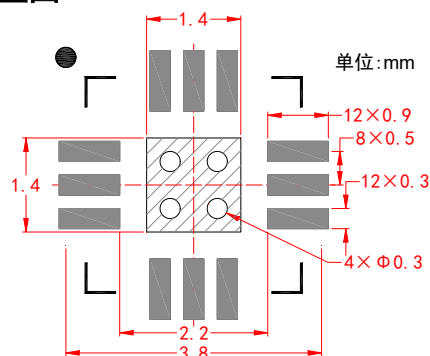
外形尺寸图：



字符标志：

标识	说明	备注
YDC8502	产品型号	不含型号尾缀
▲	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

推荐焊盘图：



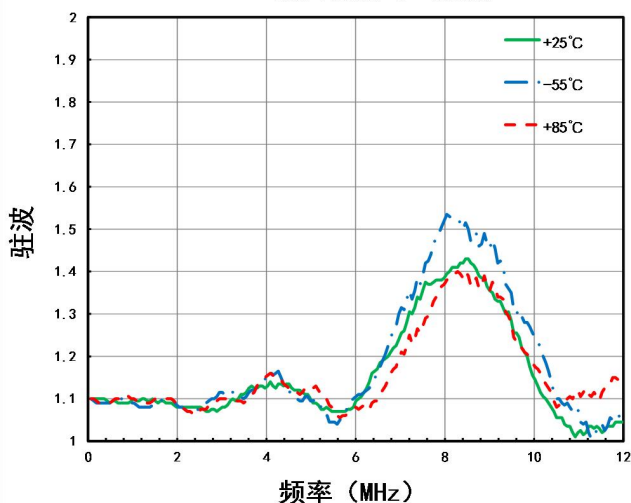
注：1、单位：mm，未注明公差按 GB/T 1804-m；

2、产品采用 QFN 塑封封装，引脚表面镀镍钯金
(Ni:0.5~2.0um, Pd:0.02~0.15um, Au:0.003~0.015um)；

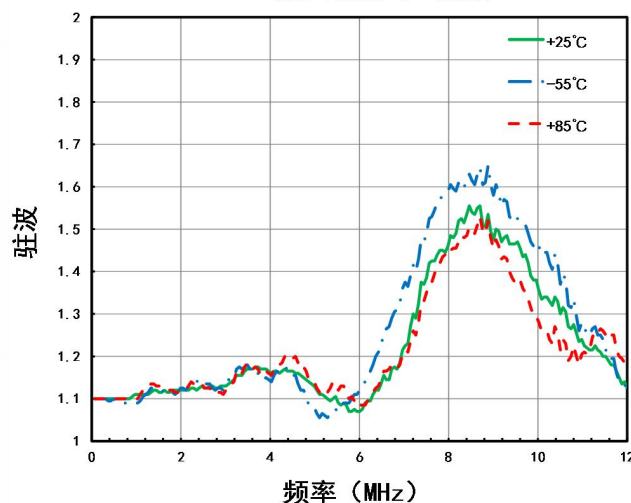
3、产品标识采用激光刻字。

典型测试曲线：(50Ω系统)

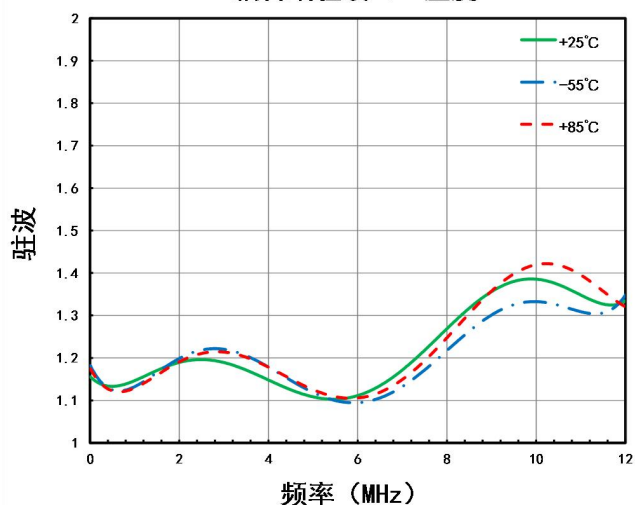
RF1端口驻波 VS. 温度



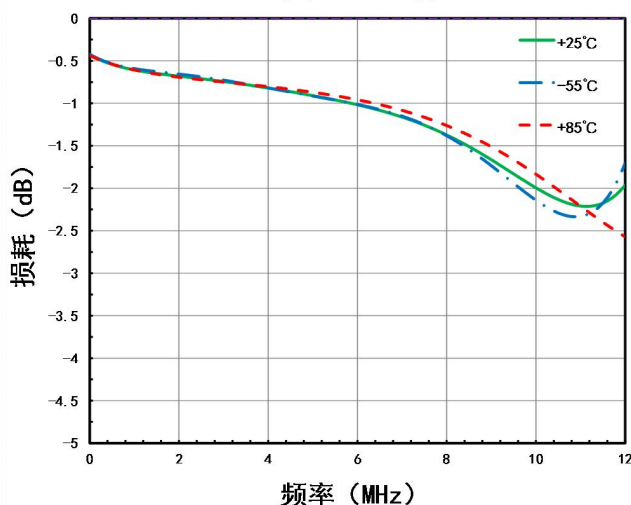
RF2端口驻波 VS. 支路



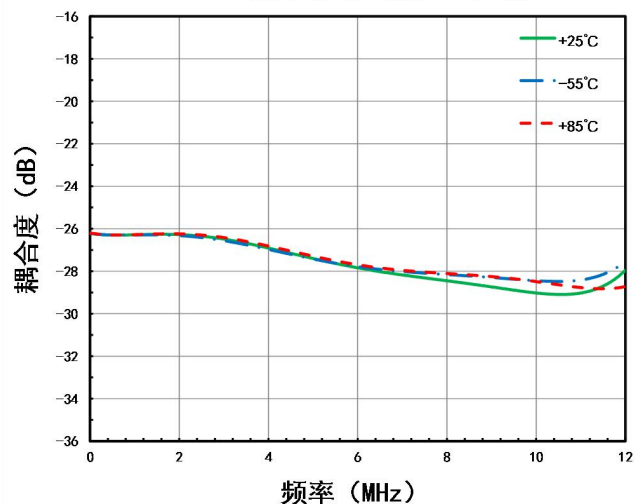
耦合端驻波 VS. 温度



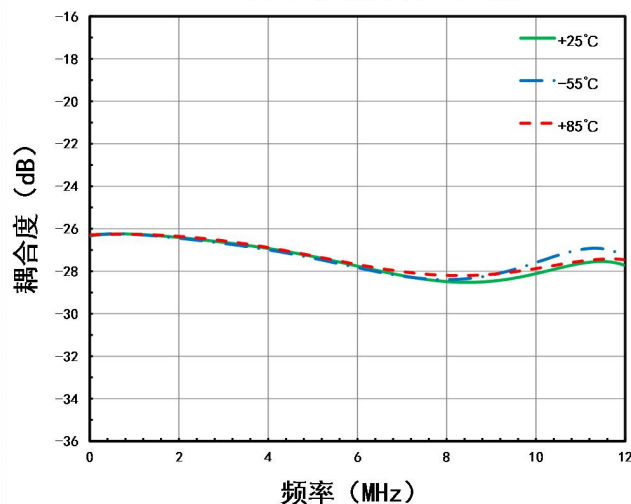
损耗 VS. 温度



RF1→耦合端 耦合度 VS. 温度

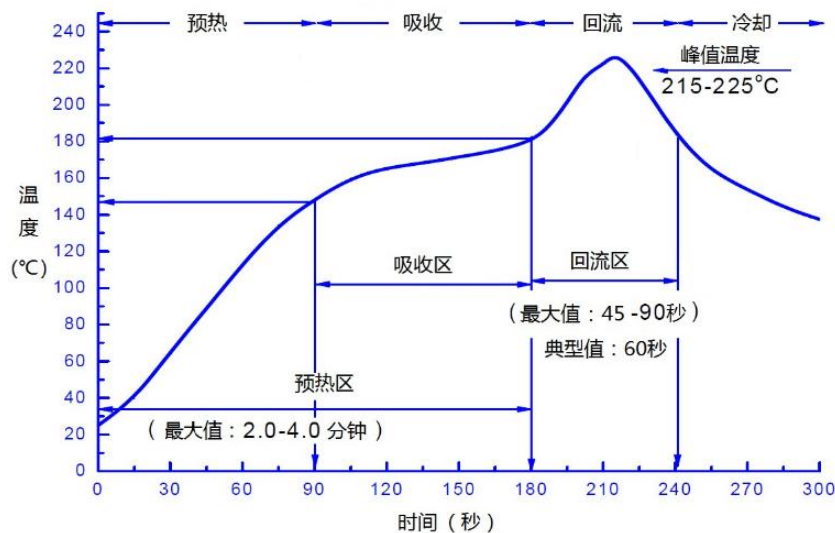


RF2→耦合端 耦合度 VS. 温度



产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
2. 产品属于 3 级潮湿敏感器件，产品在存储、操作、运输、包装使用过程须按 IPC/JEDEC J-STD 相关要求执行。
3. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）。
4. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点+183°C回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

- 如特殊情况产品需进行返工返修处理，在返工返修前应按 IPC/JEDEC J-STD MSL3 级要求对器件进行烘烤处理，避免返工返修过程加热对器件造成热损伤。回流及返工返修次数不大于 3 次。
- 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。